



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20081216001A
2009 年 4 月 3 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

CC1020/1021xxx製品 STATSChipPac社 組立サイト変更のご案内
(パッケージ外形寸法図/製品名説明追加)

(初版 PCN20081216001 2008 年 12 月 22 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	下記変更についてパッケージ外形寸法図/製品名説明追加の連絡になります。 CC1020/1021xxx 製品 STATSChipPac 社 組立サイト変更 現行：AMS 社(オーストリア) 変更後：STATSChipPac 社(シンガポール)	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	3 月下旬の出荷より実施しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	-	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更についてパッケージ外形寸法図/製品名説明追加の連絡で、通知のみを目的としたものになります。変更時期に関しましては、既報初版 PCN20081216001 (2008 年 12 月 22 日発行) の内容が適用されます。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) "CC1020/1021xxx" 製品について、現行の製造サイト AMS 社 (オーストリア) に替わり、STATSChipPAC 社 (シンガポール) 製造への移行を認定しました。製造サイト毎の製造部材は下記の様になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性 (寸法/公差)、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立サイト	AMS 社 (オーストリア)	STATSChipPAC 社 (シンガポール)

理由：安定供給確保の為

対象製品リスト

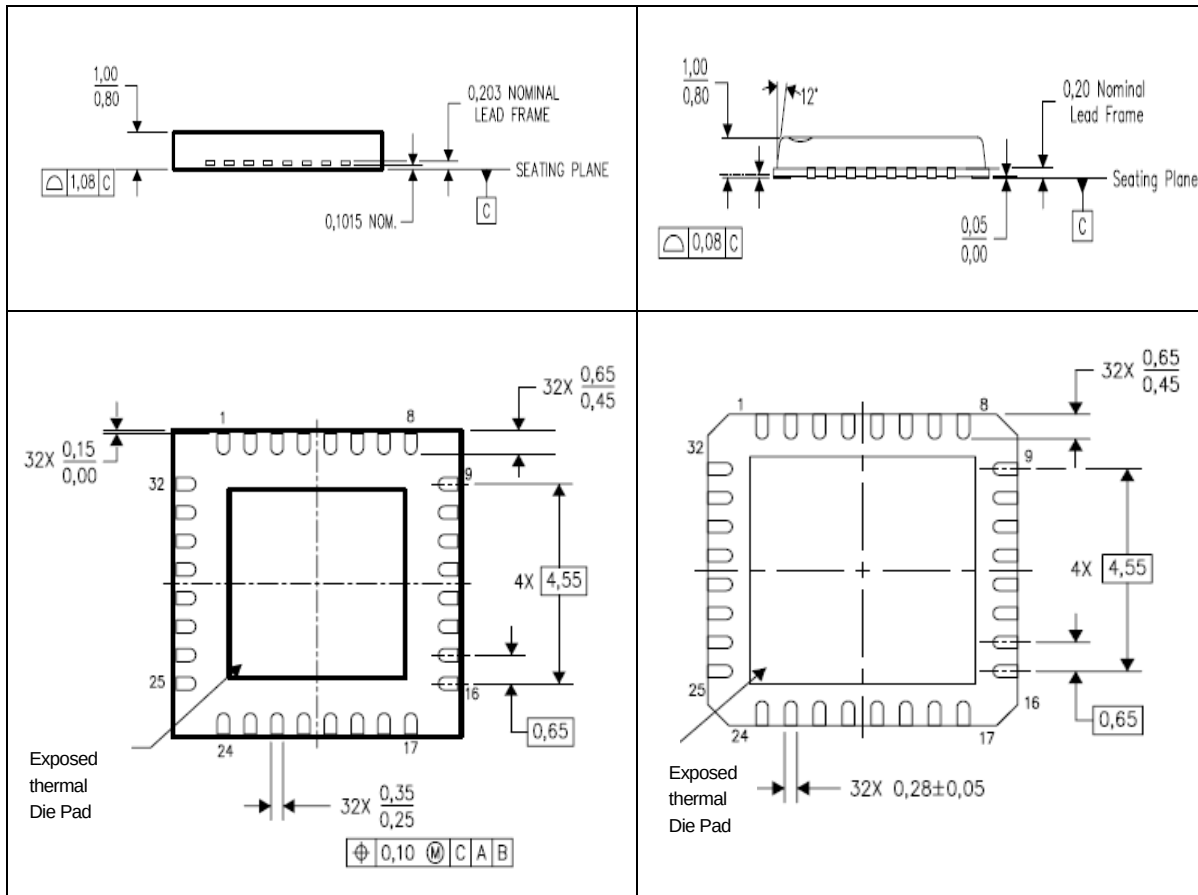
対象製品名				
CC1020RSS	CC1020-RTR1	CC1021RSS	CC1021-RTR1	HPA00471RSSR
CC1020RSSR	CC1020RUZ	CC1021RSSR	CC1021RUZ	
CC1020-RTB1	CC1020RUZR	CC1021-RTB1	CC1021RUZR	

詳細：今回の変更に伴い、下図の通り外形に若干の差異が発生しますが、RUZ パッケージは、RSS パッケージとの下位互換性が確保されており、プリント基板フットプリントの変更は必要ありません。弊社において、CC1020RSS 製品で使用されていた同一の CC1020EM 基板に CC1020RUZ 製品を実装して評価を実施し、問題がないことを確認しております。

項目	現行	変更後
組立サイト	AMS 社 (オーストリア) / ASE 社 (韓国)	STATSChipPac 社 (SGP)
Package Designator	RSS	RUZ
Leadframe	CDA 194, 100/0 Sn/Pb	NiPdAu finishing
Mold Compound	HITACHI CEL-700ZHF10	MCSM0051
Bond Wire	Au, 32 μ m	UB, Au, MK Electron (MKE), 25.4 μ m

パッケージ外形寸法図 (詳細寸法につきましてはデータシートを参照ください。)

現行	変更後
パッケージコード:RSS	パッケージコード:RUZ
Pin 1 index area top and bottom	Pin 1 index area top and bottom



備考：最新のデータシート記載の” Package Option Addendum” 項にて、RUZ パッケージ発注製品名の変更が記載されています。発注製品名は RUZ パッケージコードを反映するように変更しますが、弊社において、旧製品名も旧パッケージ製品として認識し、受注作業を実施します。

旧製品の在庫が無くなった時点で、変更後組立サイトにおける RUZ パッケージ製品のための組立/出荷になることをご承知ください。旧製品名は、発注可能な代替製品名として残りますが、旧製品パッケージに対する実際の製造は実施されません。お客様におきまして、新製品名への移行をお願いいたします。

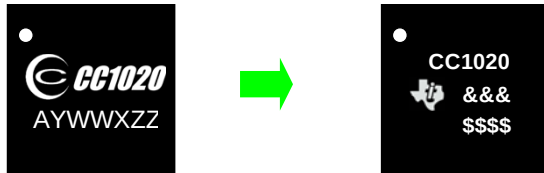
製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(22L)/原産国(23L)の表示が下記の様になり、出荷ラベル表示箇所例を示します。また、製品捺印表示の変更について記載します。尚、現行 AMS 社(オーストリア)の組立協力会社として、ASE 社(韓国)が組立を実施している為に、組立サイトの表記が ASE 社(韓国)になっております。

項目	現行	変更後
組立サイト	ASE 社(韓国)	STATSChipPac 社(SGP)
原産地(22L):ASO	KOR	STS
原産国(23L):ACO	KOR	SGP



図 1 出荷ラベルの表示箇所の例



A = Code for Pb-Free
Y = Year
WW = Mfg. Week
X = Code for ASE
ZZ = Letters for free choice

&&& = 1st 3 Characters of trace code(86M)
\$\$\$\$ = Last 4 characters of trace code(11CG)

図 2 製品捺印表示の例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	CC1020RUZ	Die Size (mm):	3.6576 X 2.8702
Die Protective Coating:	10KACN	-	-
Assembly Site:	SCS/SCSAT	Package/ Code/ Pin:	VQFN / RUZ/ 32
Mount Compound:	EPAB0009	Mold Compound:	MCSM0051
Bond Wire:	1.0 mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC, LEVEL3-260C	-	-

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails
ESD - HBM	500 V	3/0
ESD - CDM	250 V	3/0
ESD - MM	50 V	3/0
** Temp Cycle	-65/150C, 1000 cyc	77/0
** Autoclave	121C, 96 hrs	77/0
Thermal Path Integrity	JEDEC-L3,192hrs/30C / 60%	12/0
X-Ray	Top / Side	5/0
Physical Dimensions	Per package drawing	5/0
Latch Up	Electrical Test	6/0
Electrical Char	Full temp & Voltage range	Pass
BLR TC	-40/125C ,Modeling	Pass
Manufacturability (A/T)	per mfg. site spec	Pass
Manufacturability (FAB)	per mfg. site spec	Pass

Note: ** Test requires Moisture Preconditioning JEDEC L3-260C